

# 事業計画及び成長可能性に関する事項

2021年6月

日本電解株式会社  
Nippon Denkai, Ltd.

# 目次

● 会社及び事業概要	.....	3
● 当社グループの製品について	.....	10
● 市場動向等	.....	15
● 業績等の推移	.....	21
● 今後の事業方針	.....	27
● Appendix	.....	32



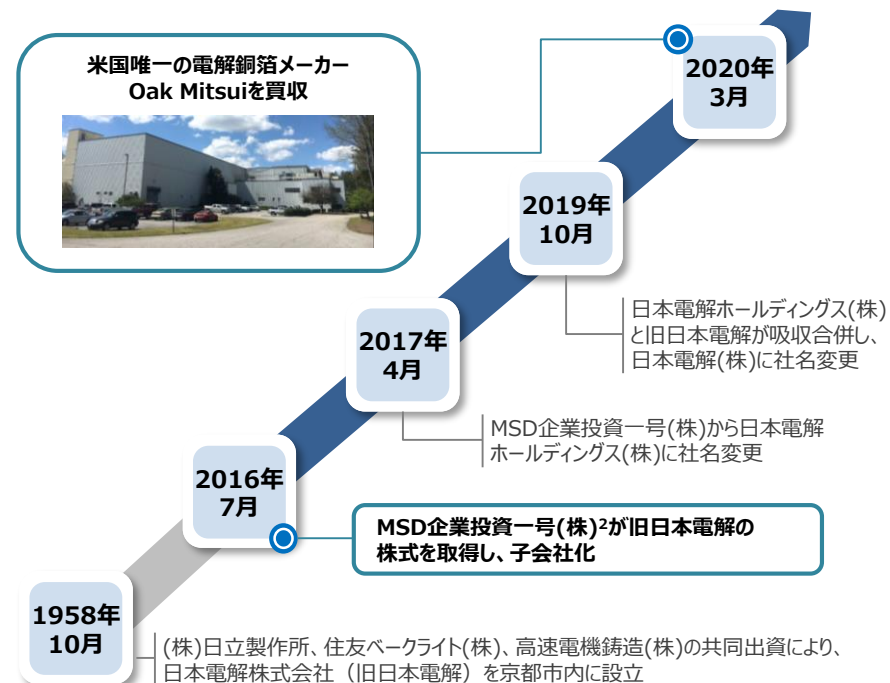
## 会社及び事業概要

会社名	日本電解株式会社（英文名：Nippon Denkai, Ltd.）
設立	1958年10月
代表者	代表取締役社長CEO 中島 英雅
本社所在地	茨城県筑西市下江連1226
資本金	100 百万円（2021年3月31日時点）
従業員数 <sup>1</sup>	241名（連結従業員数 313名）
子会社	Denkai America Inc.（本資料内においてはDAIと記載）
経営理念	グローバルな市場で選ばれる電解銅箔メーカーとして、 持続的な発展を目指します。
事業内容	車載電池用・5G等回路基板用の電解銅箔の開発・製造・ 販売
連結売上高 (2020年度)	14,584百万円
EBITDA (2020年度)	1,843百万円

<sup>1</sup> 2021年3月31日現在。臨時雇用者含む

<sup>2</sup> MSD企業投資一号(株)はMSD第一号投資事業有限責任組合、日鉄ケミカル&マテリアル(株)、徳岡工業(株)の共同出資により設立した会社です。  
なおMSD第一号投資事業有限責任組合の運営主体であるMSD企業投資(株)は、三井物産企業投資(株)、(株)三井住友銀行、(株)日本政策投資銀行の共同出資により設立された投資事業会社です。

## 当社の変遷



## 経営理念

グローバルな市場で選ばれる電解銅箔メーカーとして、永続的な発展を目指します。

## 経営ビジョン

わたしたちは、

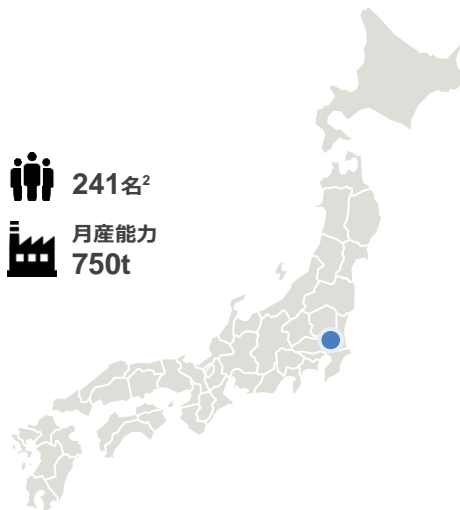
- 人と技術を大切にします。
- 広く世界に目を向け多様性を尊重し、社会から信頼される企業市民を目指します。
- 時代の変化に柔軟に適応し、顧客ニーズに迅速、誠実に応えます。
- 技術のパイオニアたるプライドを持って先端技術を探求し、研究開発に愚直に取り組めます。
- 環境や資源に配慮した事業活動を通じて低炭素社会の実現に貢献します。
- 個性や人格を認め合い、健康と安全に配慮した働きがいのある職場環境を創出します。
- 地域社会や国際社会の持続可能な発展に貢献します。
- 知識を広め、見識を高め、良識にしたがい、公正で秩序ある企業活動を行います。
- 公正かつ正確な情報開示を実践し、ステークホルダーとの建設的な対話に努めます。

## 2020年3月に**米国唯一<sup>1</sup>の電解銅箔製造メーカー**を買収し、グローバル展開を推進

### 国内拠点：本社工場（茨城県筑西市）



 241名<sup>2</sup>  
 月産能力  
750t



1984年10月  
茨城県下館市（現筑西市）に  
下館第二工場開設

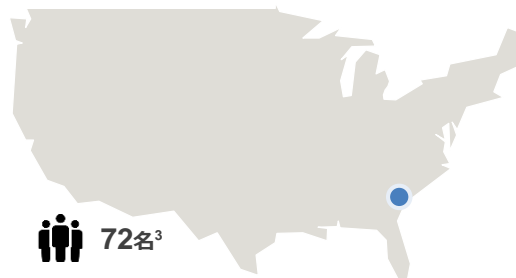
2002年1月  
本社を東京都内より茨城県下館市  
（現筑西市）に移転

2018年6月  
車載電池用銅箔 製造ライン増設

### 米国拠点：Denkai America Inc.（サウスカロライナ州カムデン）



 72名<sup>3</sup>  
 月産能力  
350t



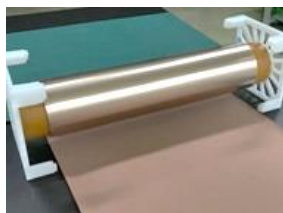
2020年3月  
旧Oak-Mitsui Inc.（三井金属鉱業  
株式会社の子会社）を買収、  
Denkai America Inc. に社名変更

<sup>1</sup> 銅箔工業会調べ <sup>2</sup> 2021年3月31日現在。臨時雇用者含む <sup>3</sup> 2021年3月31日現在

当社は、高成長が期待される市場に販路を持つグローバル電解銅箔メーカー

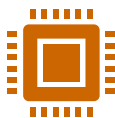
## 回路基板用銅箔

当社製品



用途

フレキシブルプリント配線板、  
半導体パッケージ基板



主要最終製品



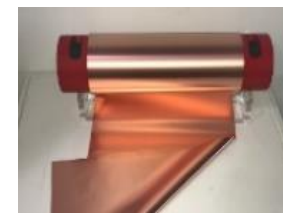
5Gスマートフォン



5G通信  
基地局 等

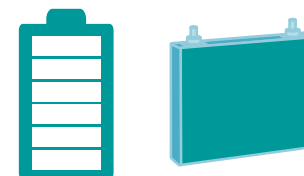
## 車載電池用銅箔

当社製品



用途

リチウムイオン二次電池 (LIB)



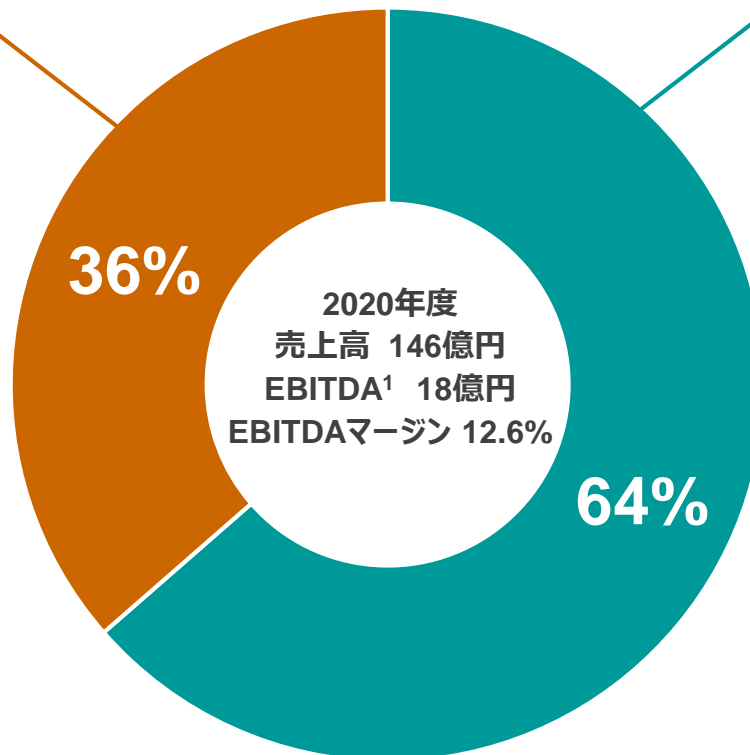
主要最終製品



EV



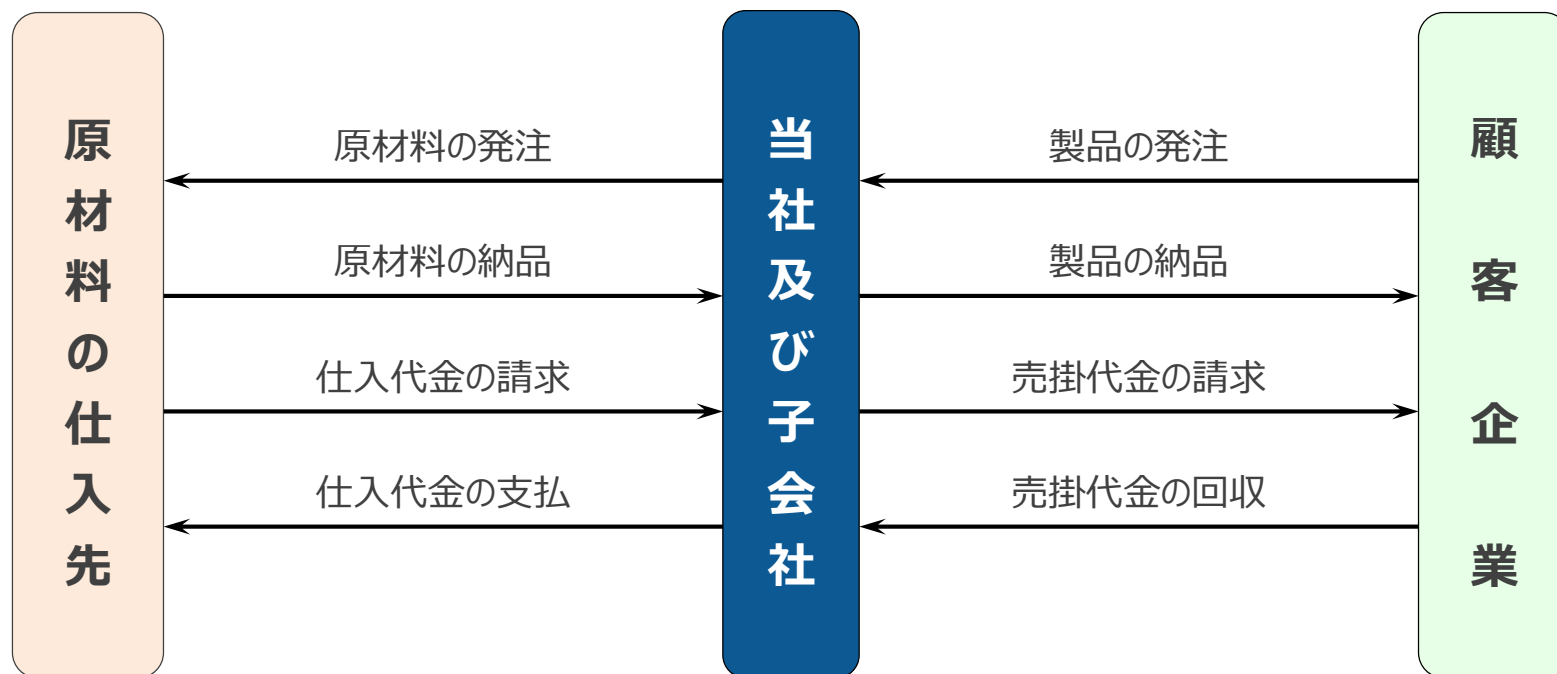
HV



<sup>1</sup> EBITDAは、営業利益に減価償却費等を足して算出しております。

当社グループは、電解銅箔の開発、製造、販売を行っており、銅箔製品を顧客に販売することにより、収益・キャッシュフローを獲得します

- 事業系統図





■ 日本電解 ■ DAI 2021年5月現在

## 代表取締役社長CEO 中島 英雅 (なかじま ひでまさ)



大手製造会社の主要ポストを経験して培った見識及び製造現場で養ったモノづくりの知見を活かし、DAI買収などの当社成長戦略を指揮

### 略歴

1977年4月 住友金属工業(株) (現 日本製鉄(株)) 入社  
2009年4月 同社 常務執行役員  
2012年10月 新日鐵住金(株) 常務執行役員 小倉製鐵所長  
2014年6月 日鉄住金エレクトロデバイス(株) 代表取締役社長  
2018年10月 日本電解 代表取締役社長CEO (現任)  
2020年3月 Denkai America Inc. CEO & President (現任)

## 取締役CFO 山本 洋一 (やまもと よういち)



大手上場企業において日米の財務・経理責任者として培った見識を基に、当社経営及び財務戦略を主導

### 略歴

1981年4月 キヤノン(株)入社  
2004年6月 キヤノンラテンアメリカ 管理部長  
2006年12月 キヤノンU.S.A., Inc. 財務部長  
2009年9月 キヤノン・コンポーネンツ(株) 取締役 管理センター所長  
2015年4月 キヤノン(株) 経理本部 経理本部長室長  
2018年8月 日本電解(株) 取締役CFO (現任)  
2020年3月 Denkai America Inc. Director (現任)

## 取締役 遠藤 安浩 (えんどう やすひろ)



銅箔の研究開発に28年従事し、当社技術開発部門にて銅箔の新製品開発及び既存製品の改良を牽引

### 略歴

1992年4月 日本電解(株) (旧 日本電解) 入社  
2010年3月 開発グループ長  
2014年7月 開発部長  
2018年6月 取締役 開発部長  
2021年1月 取締役 (現任)  
2021年5月 Denkai America Inc. Director (現任)

## DAI COO & Secretary Michael Coll (マイケル・コール)



米国エレクトロニクス業界において、研究・事業開発及び事業戦略の統括責任など20年以上の豊富な経験を持ち、DAI入社後は同社の事業戦略を指揮

### 略歴

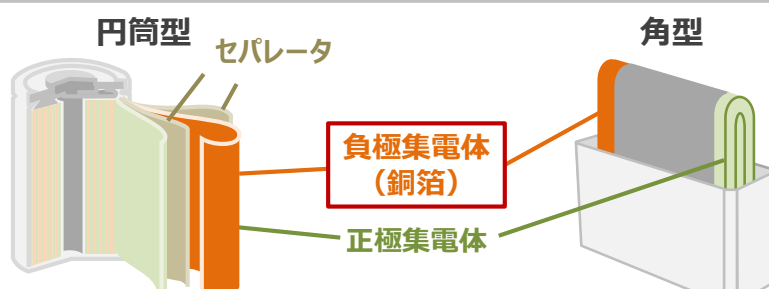
1997年4月 W. L. Gore & Associates, inc. 入社  
2006年10月 Rogers Corporation :Product Manager  
2009年10月 同社 Business Development Manager  
2013年10月 Enthone :Product Line Manager  
2015年12月 MacDermid Enthone Electronic Solutions :Director  
2019年1月 Oak-Mitsui, Inc. :Technical Director  
2020年3月 Denkai America Inc. COO & Secretary (現任)



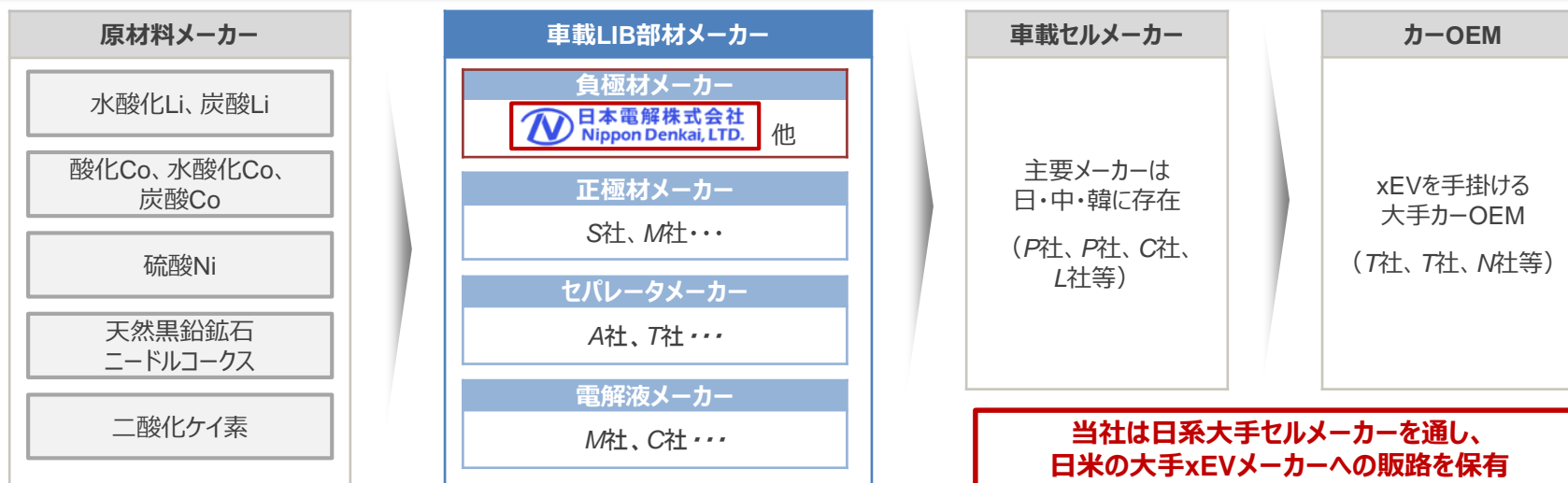
## 当社グループの製品について

当社は、車載用LIBのバリューチェーンの中でも部材メーカーとして位置づけ、**日系大手セルメーカーを通じて日米大手カーOEMへの販路を保有**

## 当社銅箔が採用されている車載用LIB

LIBの種類	銅箔に求められる要素	銅箔要求特性
	<p>充放電時の電池内部の膨張・収縮に耐えることが可能な<b>長期信頼性</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 高い伸び率：破れ難い</li> <li>● 均一な薄さ：薄い部分の発熱防止</li> <li>● 平滑性：両面とも同じ粗さ</li> <li>● 純度の高さ：低抵抗による発熱防止等</li> </ul>

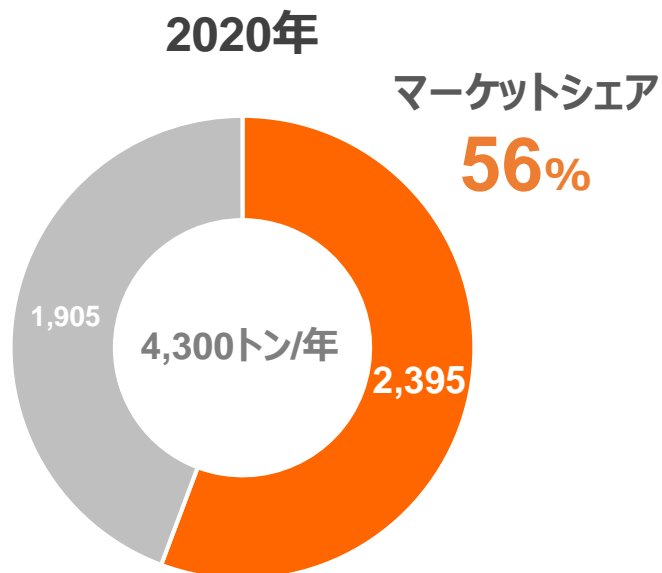
## 車載LIBのバリューチェーンにおける当社ポジション



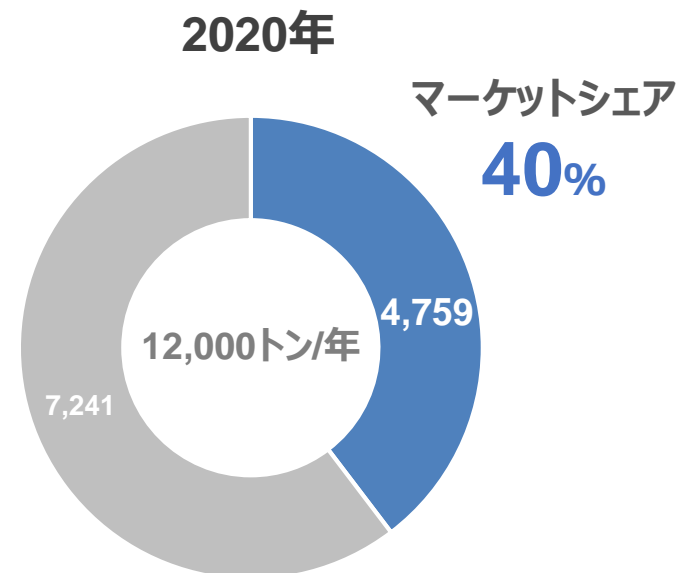
当社製品の長期信頼性及び良好なハンドリング性は市場から高い評価を受け、  
日本及び北米市場において半分近くのシェアを獲得、グローバルでのプレゼンスを発揮

### 日米市場における車載電池用銅箔のマーケットシェア

#### ● 日本市場<sup>1</sup>



#### ● 北米市場<sup>1,2</sup>



<sup>1</sup> 上記円グラフは地域別銅箔需要（Source :富士経済 車載電池用銅箔需要予測(仮数値)）と当社の日本市場及び北米市場での販売量を比較したものです。

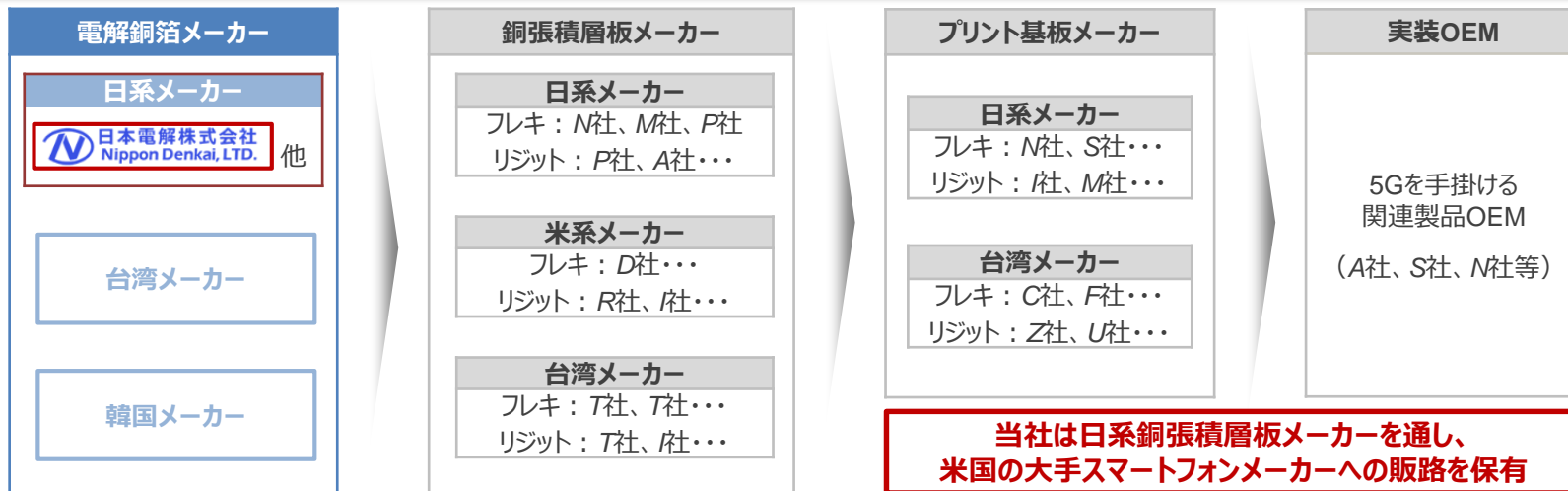
<sup>2</sup> 北米市場におけるシェアは、DAI製品を含んでおりません。

当社は、5G関連製品のバリューチェーンの中で高機能電解銅箔メーカーとして位置づけ、**日米のCCL(銅張積層板)メーカーを通じ大手実装OEMへ高機能銅箔を供給**

## 5G用銅箔の構造

	表面形状 (x5000)	断面形状 (x5000)	粗化粒子模式図	銅箔に求められる要素	銅箔要求特性
5Gタイプ 表面粗さ Rz: 1.00μm				<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>電気信号の損失</b> (伝送損失)の抑制</li> <li>● 樹脂基板との密着性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 平滑性：低表面粗さ</li> <li>● 信頼性：密着強度</li> </ul>
従来タイプ 表面粗さ Rz: 1.27μm					

## 5G関連製品のバリューチェーンにおける当社のポジション

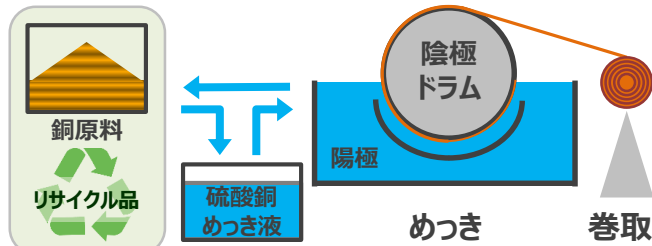


## 今後はセンシングとIoT技術を活用した工程管理のDX化を進め、品質高位安定化と高収益性の実現を目指します

### 製造工程のプロセス

#### ① ベース箔製造工程

表面形状・銅箔物性を添加剤で制御し、回転陰極ドラムに連続めっきを行う

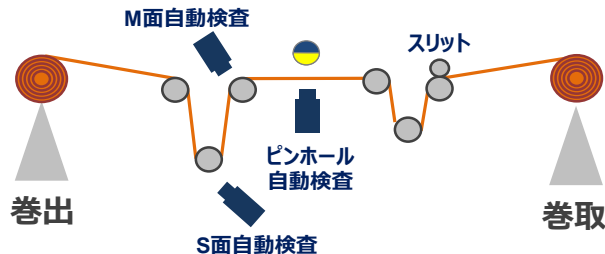


#### ② 粗化・表面処理工程

粗化・表面処理を施し、用途に合わせた防錆・有機処理を行う

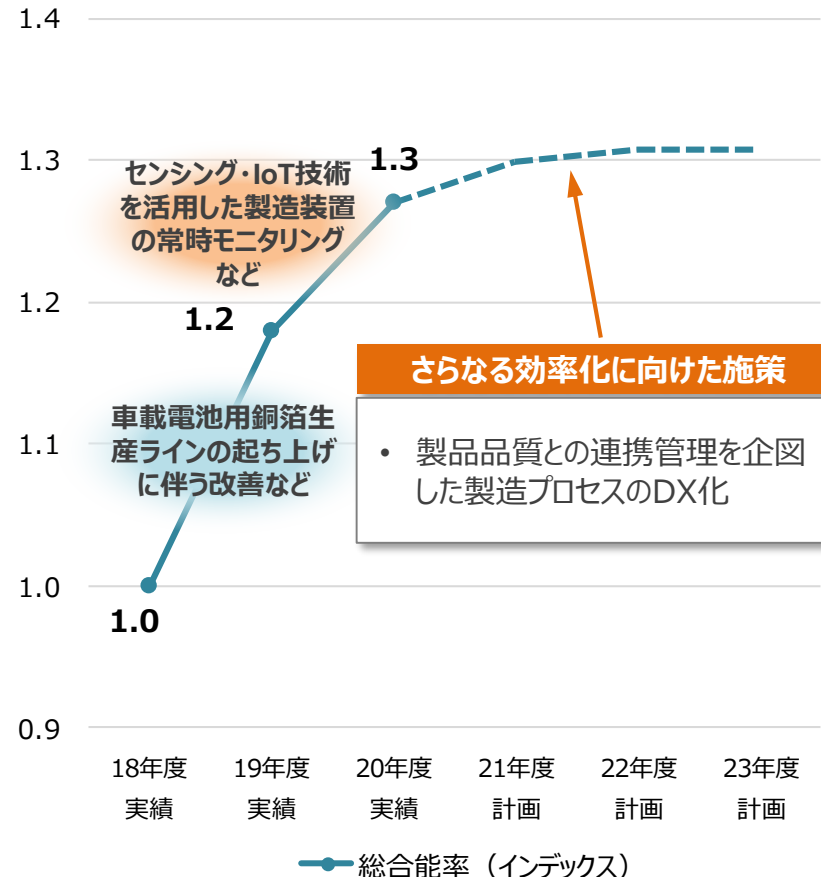
#### ③ スリット・検査工程

全量全数を自動検査後、スリット加工を行う



#### ④ 出荷

### 日本電解の製造プロセス効率化の軌跡



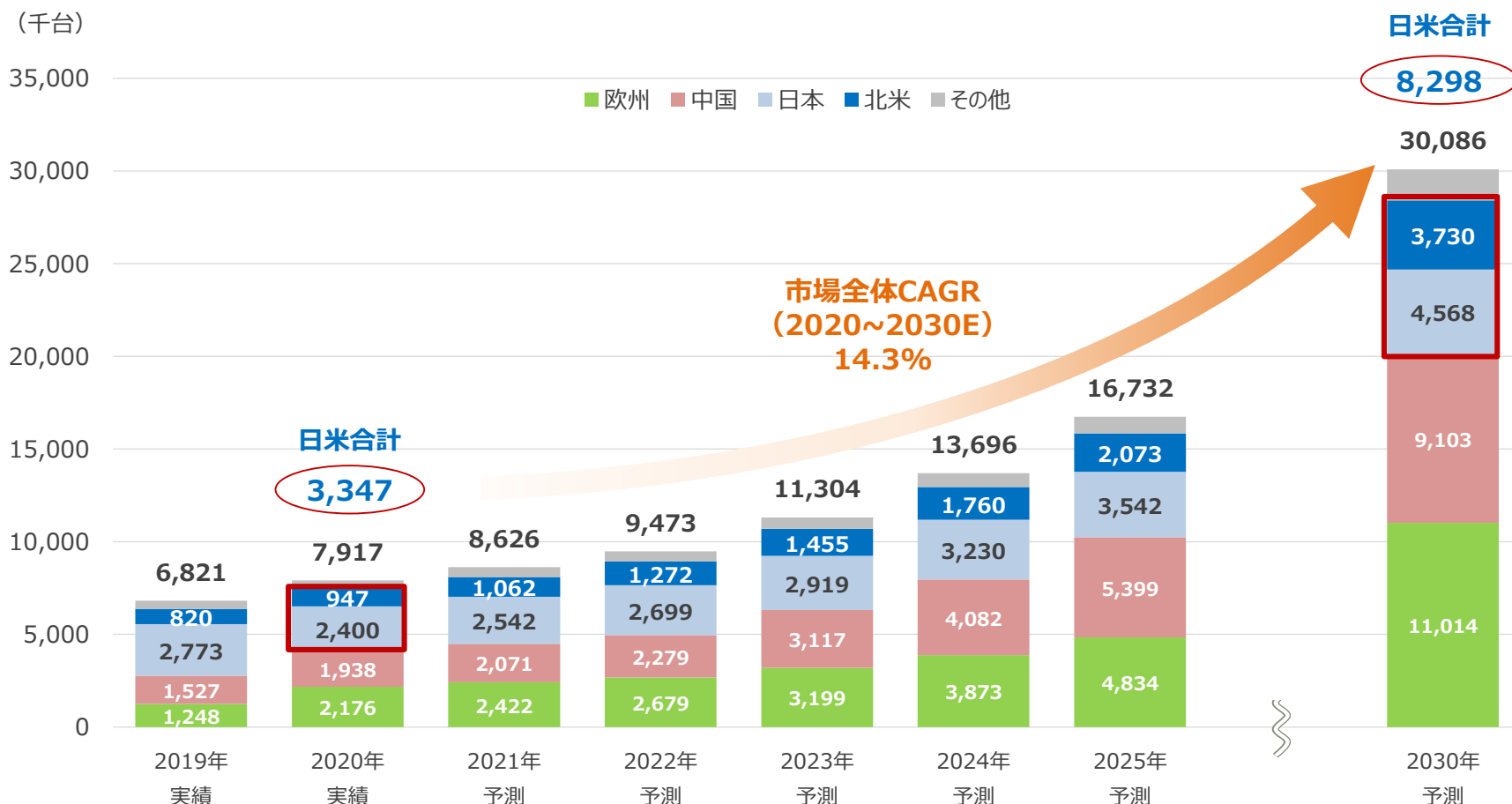
(注) 総合能率 = 稼働率% × 歩留% にて算出し、18年度実績を1.0としたインデックス形式で表現



**市場動向等**

xEV市場は各国の環境政策を受け、2030年まで14.3%のCAGRで拡大見込み。  
2030年の日米市場は、欧州・中国市場に次ぐ市場規模までに拡大。

## 今後のxEV市場の予測

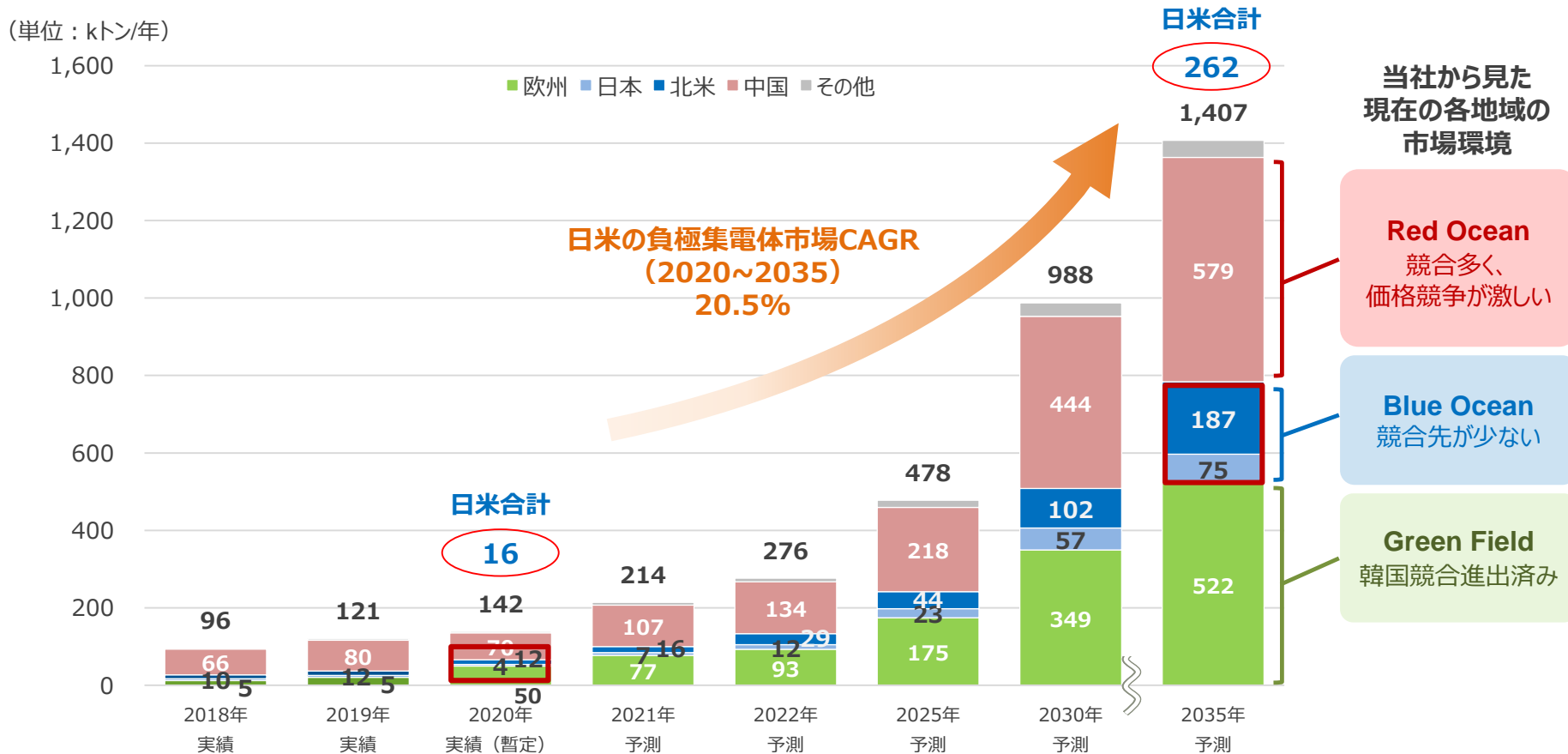


Source : 矢野経済研究所「2020年版xEV市場の現状と将来展望」。上記実績及び予測は、矢野経済研究所の集計及び推計に基づくものです。



**xEV需要拡大に伴い、車載電池用負極集電体の市場も急成長すると予測。負極集電体のほとんどは銅箔が採用され、車載電池用銅箔市場は拡大する見込み**

車両生産地域別負極集電体需要実績及び予測



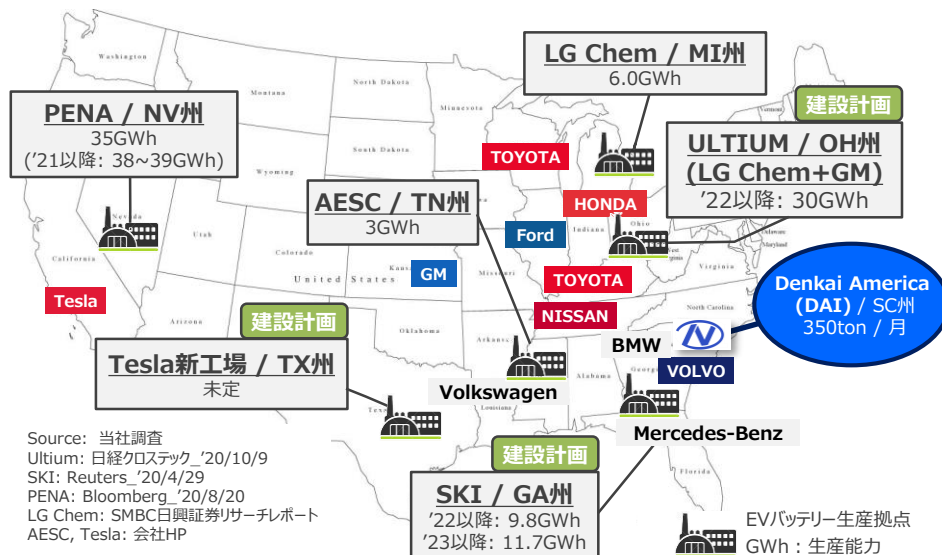
(注1) 上記グラフは、車両生産地で区分したエリア別需要量の実績及び予測であり、セル生産地によるエリア別需要量とは異なります。

(注2) 上記グラフの実績及び予測は、富士経済が、集計及び推計した数値です。

Source :富士経済 車載電池用銅箔需要予測(仮数値)

今後、各自動車メーカーは銅箔確保が課題。**米国唯一の電解銅箔メーカー**であるDAIによる現地生産メリットを生かし、早急な需要取り込みを図る

## 米国のxEV・車載LIB製造拠点マップ



## 現地調達メリット

- ① 納入リードタイム短縮**  
日本から米国西岸まで海上輸送1ヶ月、米国東岸から西岸までトラック輸送最大5日
- ② 輸送コスト削減**  
・ 長距離の海運コスト（輸送・リーファーコンテナ）の削減が可能  
・ 通い箱の利用により、梱包費及び廃棄箱の削減が可能
- ③ 納入先の在庫削減へ貢献**
- ④ 安定品質**  
・ 銅箔の品質保証期間（3~4ヶ月）に占める輸送リードタイムの削減  
・ 輸送中の外部環境の影響を低減し、銅箔品質の安定化に寄与
- ⑤ 関税・為替リスクなし**
- ⑥ バイ・アメリカン条項の恩恵**

## 参入障壁

### ● 製造ライン構築の期間短縮

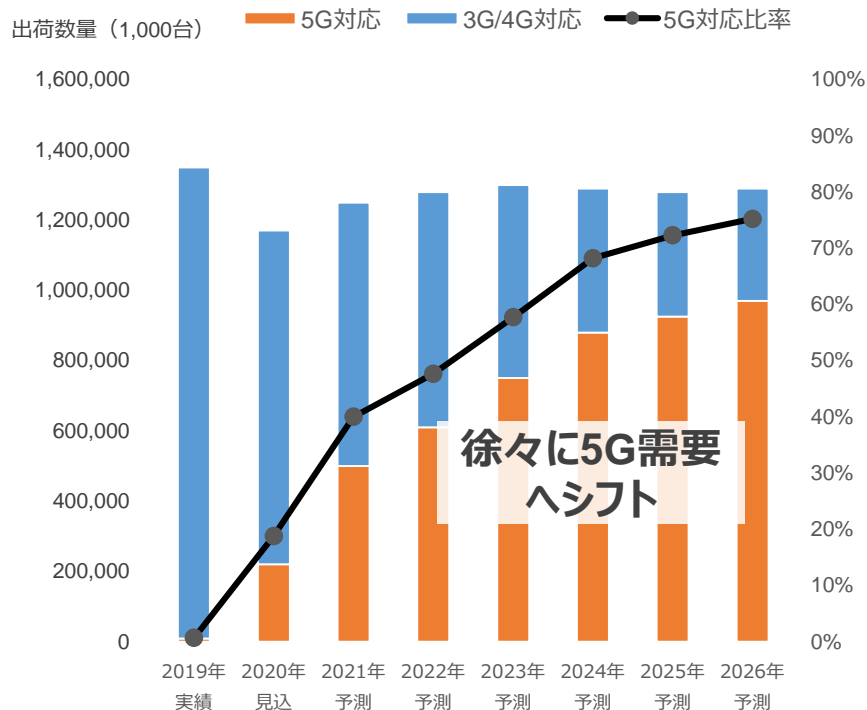


### ● 専門人材の確保のしやすさ

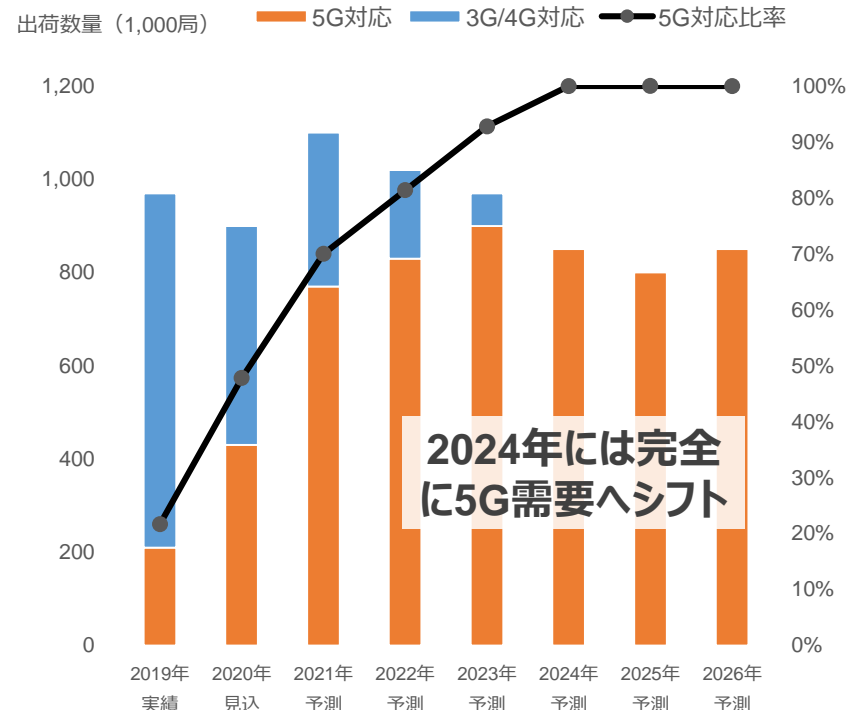
- ① 現地従業員による従業員育成体制**
- ② DAIの30年に亘る操業実績を背景にした知名度**

今後、通信関連デバイス市場全体の成長は鈍化見込み。当社は、高強度銅箔及び微細回路基板用銅箔において、**今後急激な需要拡大が見込まれる5G通信関連デバイス市場に注力する方針**

5G対応スマートフォン市場の推移



5G対応基地局（マクロセル）市場の推移

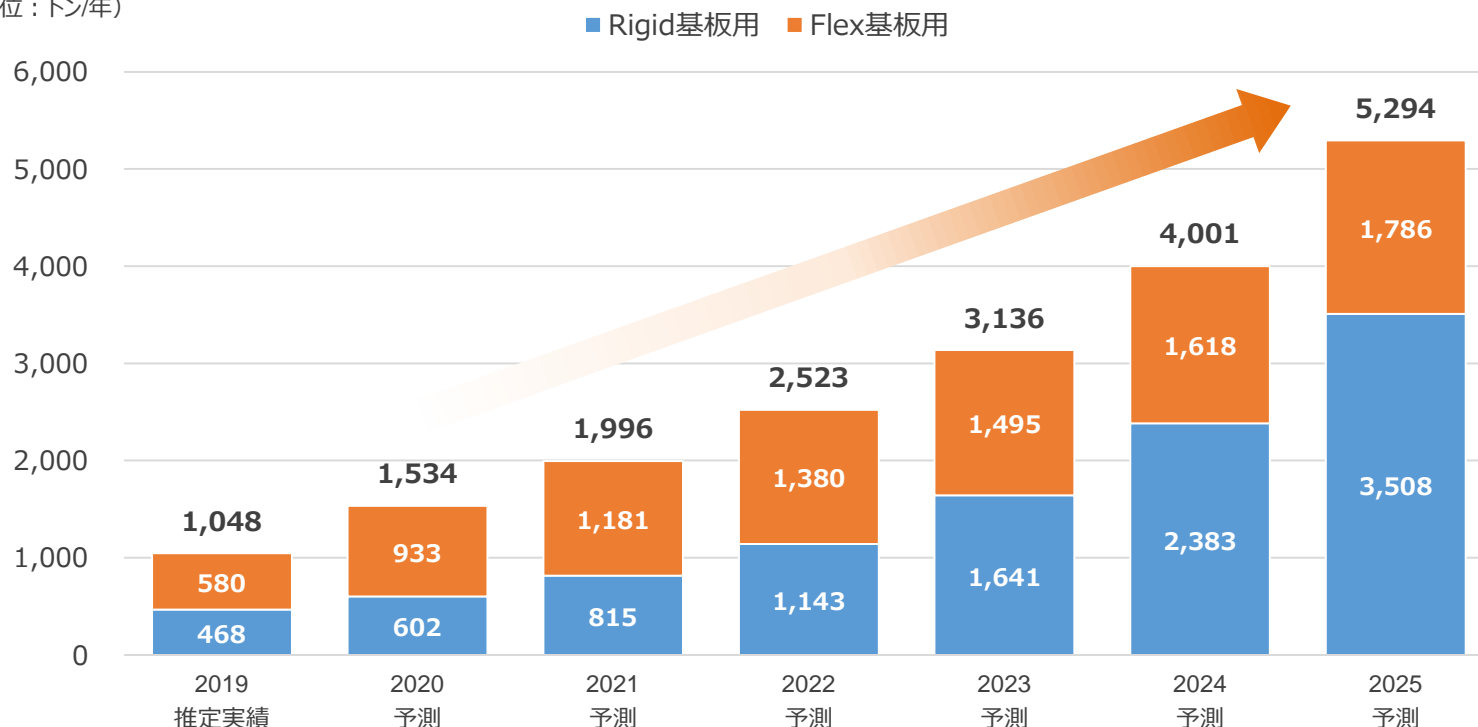


Source : 富士キメラ研究所「2020エレクトロニクス実装ニューマテリアル便覧」。上記グラフはいずれも富士キメラ研究所の推定に基づく。

高速通信化が進む5G・IoT需要の高まりを受け、信号強度の減衰（伝送損失）を最小限に留める**高機能銅箔の需要も大きく成長すると予測**。当社では、**高機能箔である高強度銅箔及び微細回路基板用銅箔に注力する方針**

5G向け基板別銅箔使用量（推定実績及び予測）

（単位：トン/年）



Source 富士キメラ総研

（注1）富士キメラ総研作成の低誘電対応銅張積層板及びフレキシブル銅張積層板の出荷量、並びに用途別市場動向の割合についての実績、見込及び予測（いずれも富士キメラ総研の推定値）を基に、5G向けに使用される銅箔需要について、当社にて重量単位に換算した上で、上記グラフを作成しています。

（注2）上表においてRigid基板用は、PPE系及びPTFE系をいい、Flex基板用とは、MPI及びLCPをいいます。

（注3）Rigid基板用の5G向けに使用される銅箔需要を算出するに当たり、Rigid基板用のうちPPE系については、用途別市場動向のうち基地局の用途の割合を、5G向けに使用されるものとして算出しています。

（注4）2021年乃至2025年の製品タイプ別の用途の割合の予測は、富士キメラ総研の2020年の見込み及び2026年の予測についての推定値を基に当社にて算出しています。



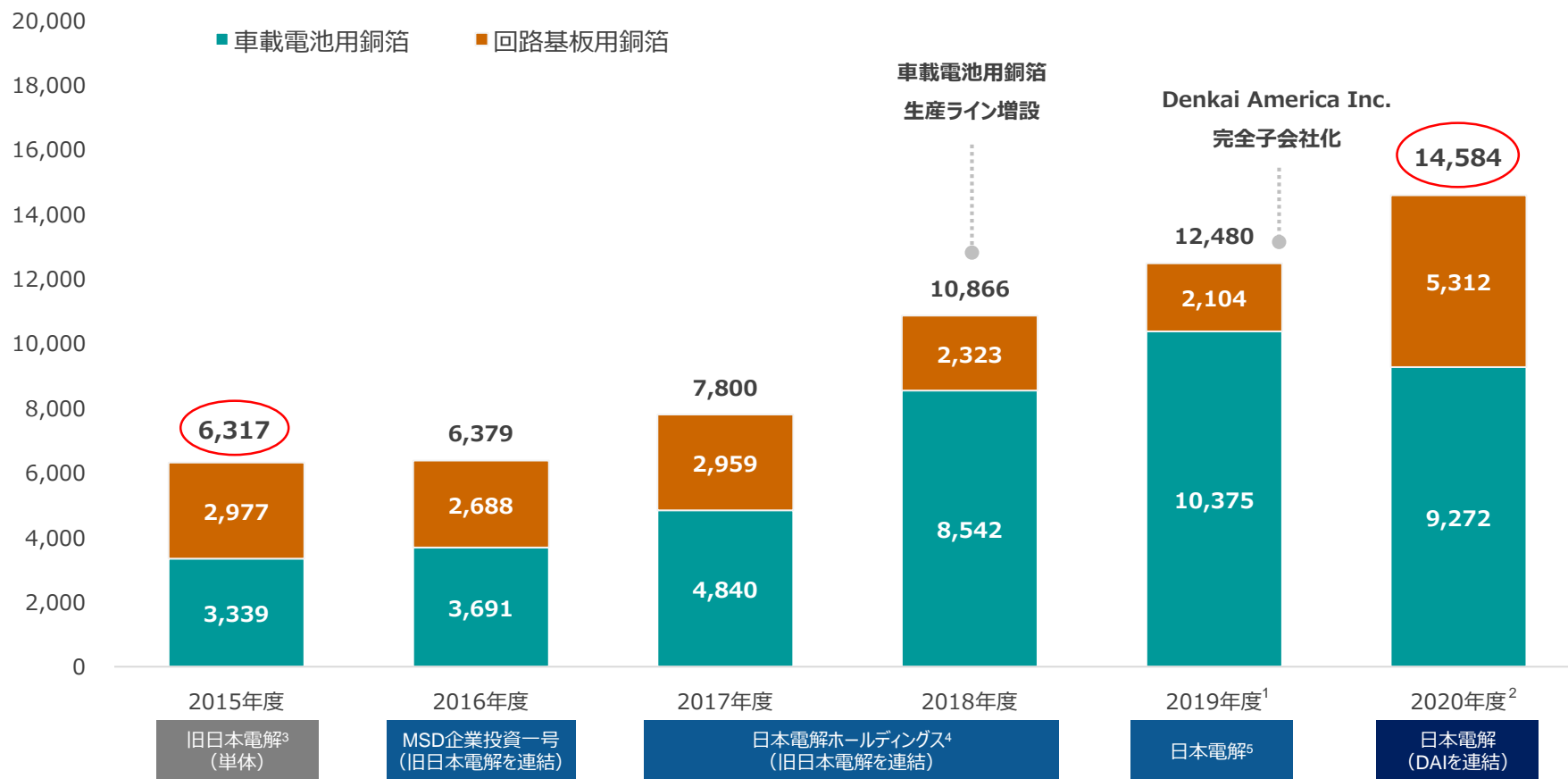
## 業績等の推移

当社グループが経営上重視する経営指標には以下のものがあります

経営指標	この経営指標を重視する理由
生産数量 (トン数)	当社グループの生産販売活動の進捗状況について、銅価格の騰落による影響額を除外して把握するための指標として、生産数量（トン数）を重視しております
営業利益	当社グループの収益獲得状況を測る基礎的な指標として、営業利益を重視しております
EBITDA	当社グループは生産設備を多数保有しているため、減価償却費や金利負担等の影響を補正したEBITDAを重視しております
EBITDAマージン	EBITDAの数値とあわせて、業務の効率性や収益性を測る指標としてEBITDAマージンを重視しております

当社は車載電池用銅箔を主体に成長を継続しており、今後は車載電池に加えて  
**5G基地局向け銅箔及びDAIの成長をドライバーとして、更なる成長を企図**

(単位：百万円)



<sup>1</sup> 2019年度において、新型コロナウイルス感染拡大による当社の事業への大きな業績的影響はございません。

<sup>2</sup> 2020年度の売上高及び品種別売上高には、DAIの実績値を含みます。

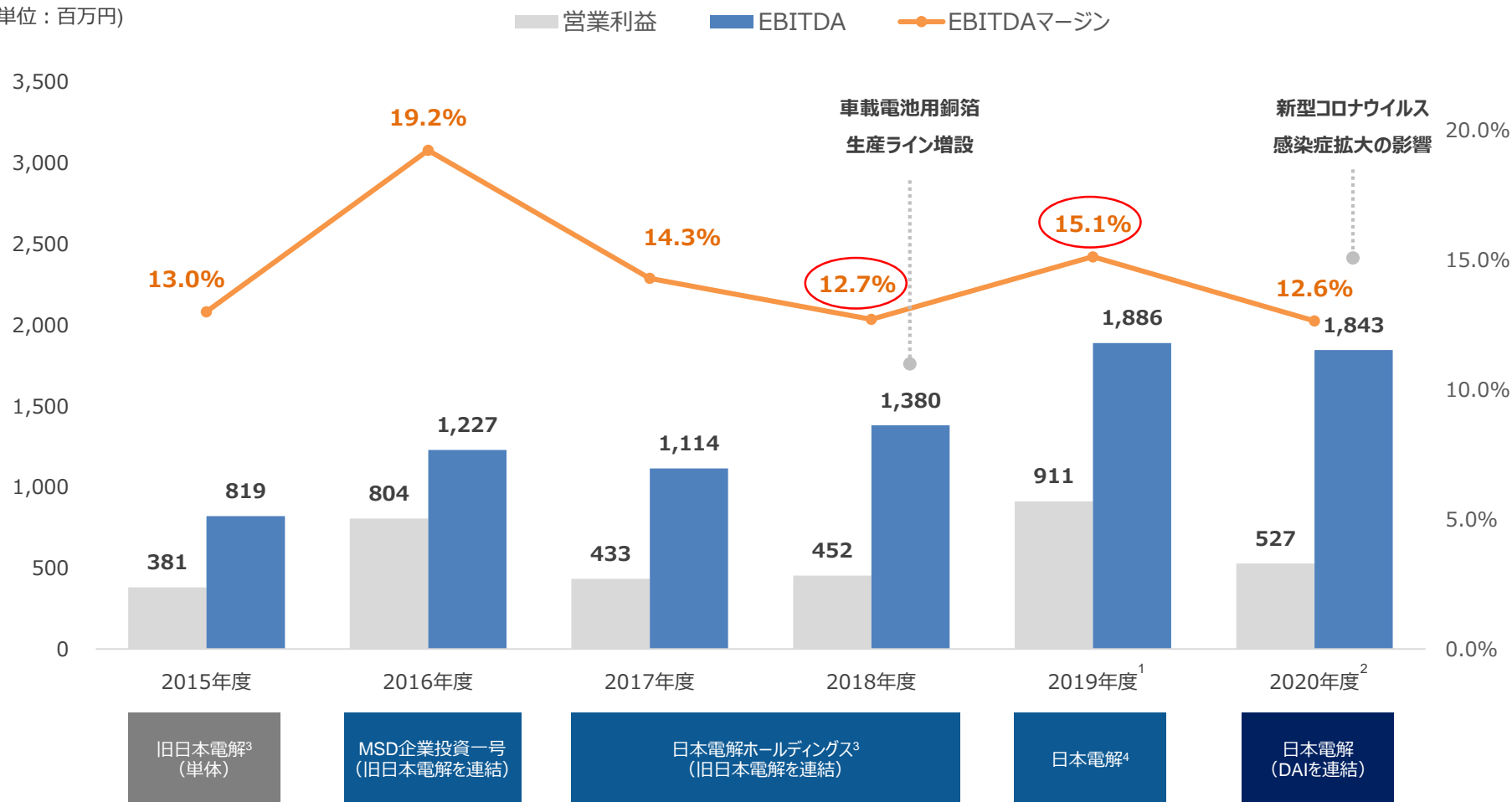
<sup>3</sup> 1958年10月に設立された日本電解株式会社を旧日本電解と表記しています。以下同様です。

<sup>4</sup> 2017年4月、MSD企業投資一号を日本電解ホールディングスへ商号変更

<sup>5</sup> 2019年10月、日本電解ホールディングスが旧日本電解を吸収合併し、日本電解ホールディングスを日本電解へ商号変更

## 営業利益及びEBITDAは継続的に成長、EBITDAマージンも伸長。

(単位：百万円)



<sup>1</sup> 2019年度において、新型コロナウイルス感染症拡大による当社の事業への大きな業績的影響はございません。

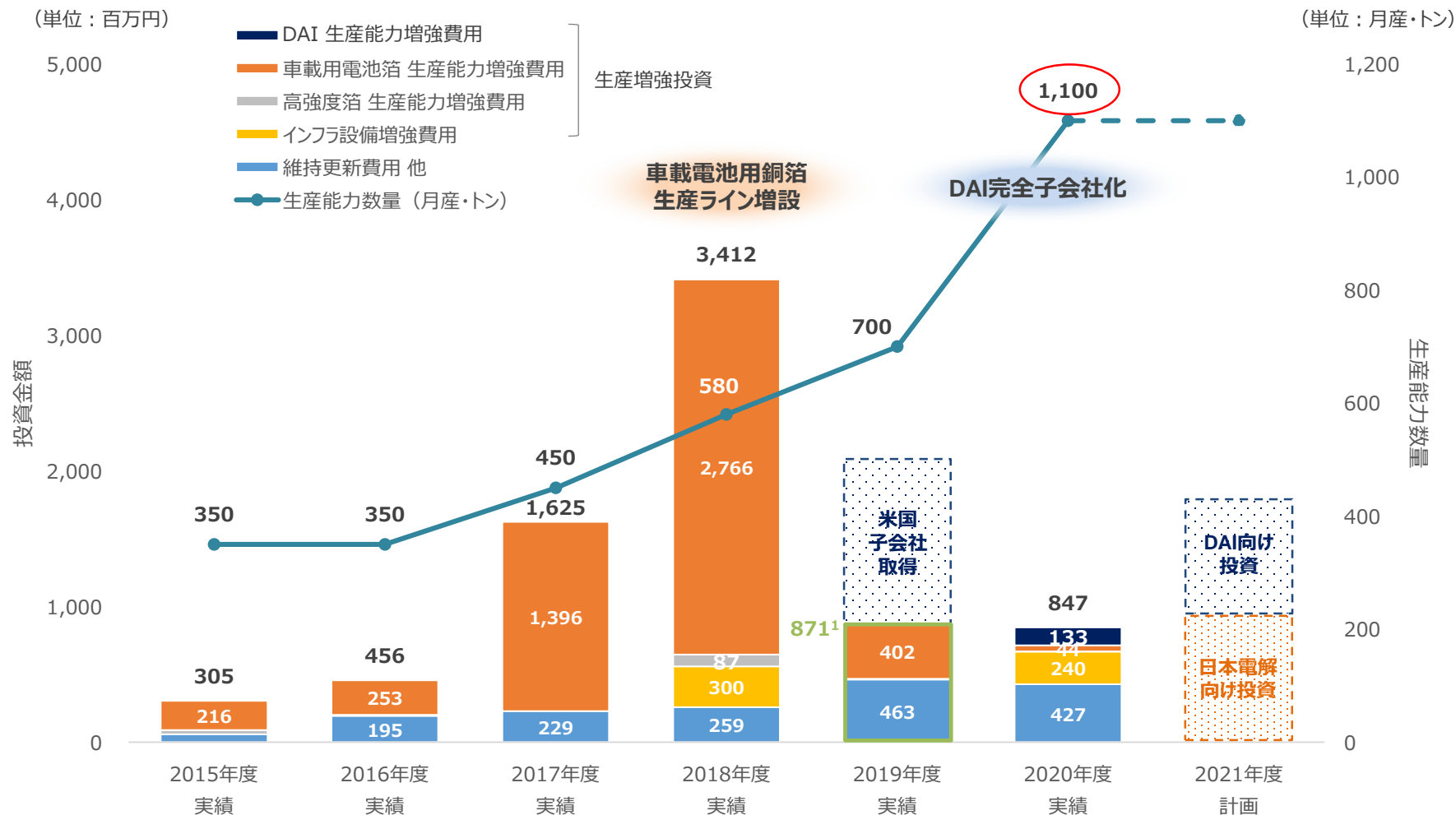
<sup>3</sup> 2017年4月、MSD企業投資一号を日本電解ホールディングスへ商号変更

<sup>2</sup> 2020年度実績の営業利益及びEBITDAには、DAIの実績値を含みます。

<sup>4</sup> 2019年10月、日本電解ホールディングスが旧日本電解を吸収合併し、日本電解ホールディングスを日本電解へ商号変更



当社はこれまで車載電池用銅箔を今後の成長領域と捉え、戦略投資を実行。  
2018年度には専用製造ラインの増強が完了し、需要増加を見据えた体制を整備



<sup>1</sup> 米国子会社取得費用を除く合計値

# 当社グループ°主要販売先（2020年度実績）

当社は、日系大手車載電池メーカーや日米の大手電子部品メーカーへの販売実績があり、**安定的な収益基盤を構築**

## 日本電解の主要販売先

相手先	販売品目	販売額 (百万円)	割合 (%)
パナソニック(株)	車載電池用 /回路基板用	8,145	71.6%
プライムアースEVIナジター(株)	車載電池用	1,227	10.8%
X社	回路基板用	953	8.4%
Y社	回路基板用	822	7.2%
Z社	回路基板用	108	1.0%
ほか 4社	回路基板用	117	1.0%
合計		11,374	

## DAIの主要販売先

相手先	販売品目	販売額 (千USD)	円貨換算額 <sup>1</sup> (百万円)	割合 (%)
Isola	回路基板用	10,060	1,067	33.3%
Insulectro/CAC	回路基板用	4,251	451	14.1%
AGC Nelco	回路基板用	3,262	346	10.8%
DuPont	回路基板用	2,789	295	9.2%
KCE	回路基板用	2,708	287	8.9%
ほか	回路基板用	7,182	762	23.7%
合計		30,252	3,209	

<sup>1</sup> 円貨換算額は、FY2020の期中平均レートUSD=@106.10で換算



## 今後の事業方針

## 生産体制強化、競争力強化を通して、持続的成長を実現

### 生産体制強化

### 日米生産体制の早期拡充及び顧客基盤拡大でシェア確保

- DAIにおける車載電池用銅箔製造能力を強化／①既存製造ラインの車載電池用銅箔製造ラインへ改造、②需要に応じた米国新工場設立
- 日本からの技術支援によるDAIの生産プロセスを最適化

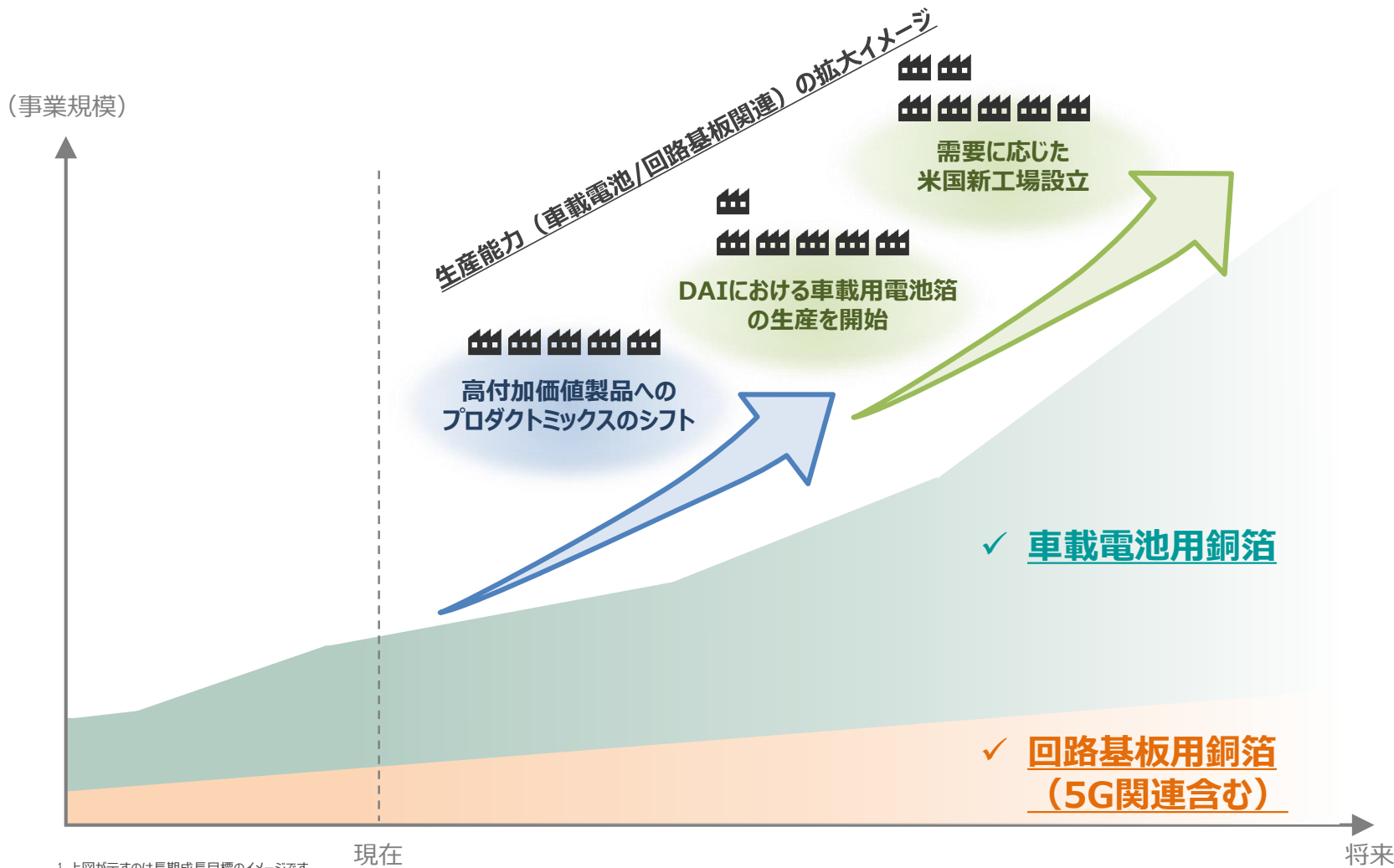
### 競争力強化

### 高付加価値商品・技術への注力による競争力強化

- 収益率の高い5G・HDI市場向け回路基板用銅箔の販売強化／①新規顧客開拓、②表面処理能力の増強
- 全固体電池などの次世代成長領域での研究開発の取り組み



今後は高付加価値製品へプロダクトミックスのシフトを行い、**車載電池用銅箔の成長**を基軸にグローバルで大きく事業規模を拡大



<sup>1</sup> 上図が示すのは長期成長目標のイメージです。

## 車載用電池銅箔によるxEV普及への寄与、および銅原料の100%再利用により、持続可能な社会の実現に貢献していきます

### xEVの普及に貢献し、脱炭素社会の実現へ。



地球温暖化対策は喫緊の課題であり、脱炭素社会の実現が求められています。当社では、車載電池用銅箔の供給及び高品質化を通して、xEVの普及に寄与することを通じ、脱炭素社会の実現に貢献いたします。



当社では、銅箔の原材料となる銅材料はすべてリサイクル品を使用し、また製造過程で発生する銅箔屑もリサイクル化しています。

銅原料



製造過程の  
銅箔屑



### 限りある資源を有効活用する、持続可能な社会の実現へ。

以下には、当社が事業展開その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項について記載しております。その他のリスクは、有価証券報告書「事業等のリスク」に記載の内容のうち、成長の実現や事業計画の遂行に影響する主要なリスクを抜粋して記載しております。その他のリスクは、有価証券報告書の「事業等のリスク」をご参照ください。なお文中の将来に関する事項は、現在において当社が判断したものであり、将来において発生する可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。また当社のコントロールできない外部要因や必ずしもリスク要因に該当しない事項についても記載しております。

	リスク要因	発生可能性	現在の影響度	当社グループの施策等	施策後の影響度	
事業活動にかか るリスク	銅価格変動	当社グループの製品は、高純度の銅材料を主原料としており、市況変動による製造原価への影響がある	大	小	主要顧客との間で、銅価格を基準として販売価格を決定する「銅価スライド制」を導入する等、銅価格変動による収益への影響の最小化に努めております	小
	為替相場変動	外貨建て資産、負債、収益ならびに費用の円貨換算額は、為替相場の状況に応じて増減する	中	小	外貨建ての債権債務が発生した場合や、在外子会社への投資を実行する場合には、為替予約の実行等により為替変動リスクをヘッジしております	小
	特定取引先への依存	主要顧客への販売額が当社の連結売上高の過半を占めるため、主要顧客の業績及び購買方針の影響が大きい	小	大	今後の成長が見込まれる高付加価値領域や、海外顧客への販路拡大に取り組み、特定取引先への依存を逡減させる方針です	小
	知的財産権の保護等	当社グループの技術やノウハウを模倣した不正商品の流通や、知的財産を巡って他社との紛争が生じる可能性がある	小	小	製品の技術的優位を確保するため、技術やノウハウ等には特許出願等による保護を図るとともに、他者の知的財産権を侵害することがないように十分な注意を払います	小



# Appendix



# 業績の推移（過去5年間及び当期の実績）

	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
	旧日本電解	MSD企業投資一号 (旧日本電解を連結)	日本電解ホールディングス <sup>2</sup> (旧日本電解を連結)		日本電解 <sup>3</sup>	日本電解 (DAIを連結)
<b>売上高</b> (単位：百万円)	<b>6,317</b>	<b>6,379</b>	<b>7,800</b>	<b>10,866</b>	<b>12,480</b>	<b>14,584</b>
車載電池用銅箔	3,339	3,691	4,840	8,542	10,375	9,272
回路基板用銅箔	2,977	2,688	2,959	2,323	2,104	5,312
高強度銅箔	131	616	825	829	926	1,053
微細回路基板用銅箔	1,291	1,164	1,240	810	741	825
キャリア付極薄銅箔	757	350	417	450	372	222
汎用箔 – 日本電解	796	556	476	232	62	—
汎用箔 – Denkai America <sup>4</sup>	—	—	—	—	—	3,209
<b>営業利益</b>	<b>381</b>	<b>804</b>	<b>433</b>	<b>452</b>	<b>911</b>	<b>527</b>
(営業利益率)	6.0%	12.6%	5.6%	4.2%	7.3%	3.6%
<b>当期純利益</b>	<b>293</b>	<b>647</b>	<b>△ 45</b>	<b>22</b>	<b>1,988</b>	<b>193</b>
(売上高利益率)	4.7%	10.1%	△ 0.6%	0.2%	15.9%	1.3%
<b>減価償却費等</b>	<b>438</b>	<b>422</b>	<b>681</b>	<b>928</b>	<b>974</b>	<b>1,316</b>
<b>EBITDA<sup>5</sup></b>	<b>819</b>	<b>1,227</b>	<b>1,115</b>	<b>1,380</b>	<b>1,886</b>	<b>1,843</b>
<b>EBITDAマージン (%)</b>	<b>13.0%</b>	<b>19.2%</b>	<b>14.3%</b>	<b>12.7%</b>	<b>15.1%</b>	<b>12.6%</b>
<b>有利子負債</b>	<b>3,933</b>	<b>2,704</b>	<b>3,439</b>	<b>5,589</b>	<b>6,459</b>	<b>6,010</b>
<b>ネット有利子負債</b>	<b>2,897</b>	<b>816</b>	<b>2,102</b>	<b>4,991</b>	<b>5,205</b>	<b>4,348</b>
<b>総資産額</b>	<b>5,302</b>	<b>6,834</b>	<b>7,565</b>	<b>10,227</b>	<b>13,747</b>	<b>13,643</b>
<b>純資産額</b>	<b>122</b>	<b>2,484</b>	<b>2,438</b>	<b>2,461</b>	<b>4,434</b>	<b>4,946</b>
<b>のれん</b>	<b>—</b>	<b>429</b>	<b>143</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>ネット有利子負債/EBITDA (倍)</b>	<b>3.5倍</b>	<b>0.7倍</b>	<b>1.9倍</b>	<b>3.6倍</b>	<b>2.8倍</b>	<b>2.4倍</b>
<b>自己資本比率 (%)</b>	<b>2.3%</b>	<b>36.4%</b>	<b>32.2%</b>	<b>24.1%</b>	<b>32.3%</b>	<b>36.3%</b>
<b>自己資本利益率 (%)</b>	<b>239.4%</b>	<b>49.7%</b>	<b>△ 1.9%</b>	<b>0.9%</b>	<b>57.7%</b>	<b>4.1%</b>
<b>財務レバレッジ (倍)</b>	<b>43.2倍</b>	<b>2.8倍</b>	<b>3.1倍</b>	<b>4.2倍</b>	<b>3.1倍</b>	<b>2.8倍</b>
<b>総資産回転率 (回)</b>	<b>1.2回</b>	<b>1.1回</b>	<b>1.1回</b>	<b>1.2回</b>	<b>1.0回</b>	<b>1.1回</b>

<sup>1</sup> 2019年度において、新型コロナウイルス感染拡大による当社の事業への大きな業績的影響はございません。

<sup>2</sup> 2017年4月、MSD企業投資一号を日本電解ホールディングスへ商号変更

<sup>3</sup> 2019年10月、日本電解ホールディングスが旧日本電解を吸収合併し、日本電解ホールディングスを日本電解へ商号変更

<sup>4</sup> 円貨換算額は、FY2020の期中平均レートUSD=@106.10で換算

<sup>5</sup> EBITDAは、営業利益に減価償却費等を足して算出しております。

<sup>6</sup> DAI全株式取得に伴う、負ののれん発生益1,441百万円が発生

1958年 10月 (株)日立製作所、住友バークライト(株)及び高速電機鑄造(株)の3社共同出資により京都市内にて設立

1961年 7月 茨城県下館市（現筑西市）に下館工場を開設、操業開始

1983年 1月 静岡県藤枝市に藤枝工場を開設、操業開始

1984年 10月 下館第二工場（現本社工場）を開設、操業開始

1985年 11月 京都工場 操業終了

1998年 6月 電池用銅箔（現・車載電池用銅箔）販売開始

2002年 1月 本社を茨城県下館市（現筑西市：下館工場内）に移転

2002年 9月 藤枝工場 操業終了

2002年 12月 微細回路基板用銅箔 販売開始

2006年 6月 キャリア付極薄銅箔 販売開始

2012年 11月 高強度銅箔 販売開始

2016年 6月 MSD企業投資一号(株)（→日本電解ホールディング(株)→現在の当社）設立

2016年 7月 株主異動 MSD企業投資一号(株)が日本電解の株式を取得し、子会社化

2018年 6月 車載電池用銅箔 製造ライン増設

2019年 10月 日本電解ホールディング(株)へ吸収合併、同時に商号を日本電解(株)に変更

2020年 3月 米国の銅箔製造会社（Oak-Mitsui Inc.）を取得、商号をDenkai America Inc.へ変更

: P.4記載項目

# 本資料の取り扱いについて

本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これら将来の見通しに関する記述は、当該記述を作成した時点における情報に基づいて作成されています。これらの記述は、将来の結果や業績を保証するものではありません。このような将来予測に関する記述には、必ずしも既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の実際の業績や財務状況は、将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示された将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。

上記の実際の結果に影響を与える要因としては、国内および国際的な経済状況の変化や、当社が事業を展開する業界の動向などが含まれますが、これらに限られるものではありません。

また、当社以外の事項・組織に関する情報は、一般に公開されている情報に基づいており、当社はそのような一般に公開されている情報の正確性や適切性を検証しておらず、保証しておりません。

今後、「事業計画及び成長可能性に関する事項」については、決算発表の時期を目途に開示を行う予定です。

